



技术简讯

[1 / 2]

FAM-CN-0064-A

FX5S CPU模块的包装变更通知

■出版年月

2023年2月

■相关机型

FX5S-30MR/ES、FX5S-30MT/ES、FX5S-30MT/ESS、FX5S-40MR/ES、FX5S-40MT/ES、FX5S-40MT/ESS、FX5S-60MR/ES、FX5S-60MT/ES、FX5S-60MT/ESS

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-F系列微型可编程控制器。
关于MELSEC iQ-F系列FX5S CPU模块的包装及包装箱尺寸的变更，特此通知。
此外，一般规格、性能规格、功能及外形尺寸与以往产品相比并无变更。

1 对象机型

品名	型号
FX5S CPU模块	FX5S-30MR/ES、FX5S-30MT/ES、FX5S-30MT/ESS、FX5S-40MR/ES、FX5S-40MT/ES、FX5S-40MT/ESS、FX5S-60MR/ES、FX5S-60MT/ES、FX5S-60MT/ESS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

2 变更内容

如下变更包装箱的尺寸与内部缓冲结构。

项目		变更前	变更后
包装箱外形尺寸	30点	166 (W) × 162 (D) × 114 (H) [mm]	156 (W) × 152 (D) × 114 (H) [mm]
	40点	196 (W) × 162 (D) × 114 (H) [mm]	186 (W) × 152 (D) × 114 (H) [mm]
	60点	242 (W) × 162 (D) × 114 (H) [mm]	232 (W) × 152 (D) × 114 (H) [mm]
包装箱的形状			

3 变更理由

为了降低环境负荷。

4 预计变更时期

从2023年2月生产的产品开始依次替换。

根据库存情况，在流通阶段新旧包装有可能同时存在。

敬请谅解。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2023年2月	第一版

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’, or ‘®’, are not specified in this technical bulletin.